

Siemens und Intel arbeiten gemeinsam an Halbleiterfertigung der nächsten Generation

- **Siemens und Intel arbeiten gemeinsam daran, Effizienz und Nachhaltigkeit der Halbleiterproduktion in den Emissions-Kategorien 1-3 voranzutreiben**
- **Halbleiter sind entscheidend für die globale Wirtschaft und ermöglichen nachhaltigere Lösungen für die Reduzierung des globalen CO₂-Fußabdrucks**
- **Intel und Siemens setzen ihre modernsten IoT-Lösungen sowie Siemens-Automatisierungslösungen ein, um die Halbleiterproduktion effizienter und nachhaltiger zu gestalten**

Die Siemens AG, ein führendes Technologieunternehmen, und die Intel Corporation, einer der weltweit größten Hersteller von Halbleitern, haben ein Memorandum of Understanding (MoU) zur Zusammenarbeit bei der Digitalisierung und Nachhaltigkeit der Halbleiterfertigung unterzeichnet. Im Rahmen der Absichtserklärung wollen sich die beiden Unternehmen auf die Gestaltung neuer Fertigungen, die Weiterentwicklung bestehender Betriebsabläufe sowie Cybersicherheit konzentrieren und ein resilientes globales Industrieökosystem unterstützen.

„Halbleiter sind zentral für unsere moderne Wirtschaft. Kaum etwas funktioniert ohne Chips. Deshalb freuen wir uns sehr, mit Intel zusammenzuarbeiten, um die Halbleiterproduktion schnell voranzutreiben. Siemens wird sein gesamtes hochmodernes Portfolio an IoT-fähiger Hard- und Software sowie elektronischer Ausrüstung in diese Partnerschaft einbringen“, sagt Cedrik Neike, CEO von Digital Industries und Vorstandsmitglied von Siemens. „Unsere gemeinsamen Anstrengungen werden dazu beitragen, die globalen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.“

In der Absichtserklärung werden Schlüsselbereiche der Zusammenarbeit festgelegt: Gemeinsam wollen Siemens und Intel eine Reihe von Initiativen forcieren, darunter die Optimierung des Energiemanagements, und die Reduzierung des CO₂-Fußabdrucks entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Die Zusammenarbeit umfasst beispielsweise die Anwendung von digitalen Zwillingen komplexer hochkapitalintensiver Fertigungsanlagen, um Lösungen für die Halbleiterfertigung der nächsten Generation zu standardisieren, bei denen jeder gewonnene Effizienzprozentsatz entscheidend ist.

Im Rahmen der Zusammenarbeit soll auch geprüft werden, wie sich der Energieverbrauch minimieren, Prozesse zur Verringerung des Verbrauchs natürlicher Rohstoffe weiterentwickeln und der ökologische Fußabdruck reduzieren lassen. Um mehr Informationen zu produktbezogenen Emissionen zu erhalten, wird Intel Produkt- und Lieferkettenmodellierungslösungen mit Siemens prüfen, die datenbasierte Einblicke bieten und der Branche helfen, Fortschritte bei der Reduzierung ihres kollektiven Fußabdrucks zu beschleunigen.

“Die Welt benötigt eine global ausgewogenere, nachhaltigere und widerstandsfähigere Lieferkette für Halbleiter, um der steigenden Nachfrage nach Chips gerecht zu werden“, sagte Keyvan Esfarjani, Executive Vice President und Chief Global Operations Officer von Intel. “Wir freuen uns, auf Intels fortschrittliche Fertigungsfähigkeiten aufzubauen, indem wir unsere Zusammenarbeit mit Siemens ausweiten und neue Bereiche erkunden. Hierbei können wir das Portfolio von Siemens Automatisierungslösungen nutzen, um Effizienz und Nachhaltigkeit in der Infrastruktur, Einrichtungen und den Betriebsabläufen der Fabriken für Halbleiterfertigung zu verbessern. Diese Absichtserklärung wird den regionalen und globalen Wertschöpfungsketten der Industrie zugutekommen.”

Nachhaltige Praktiken entlang des gesamten Lebenszyklus von Halbleitern, einschließlich Design, Herstellung, Betrieb, Effizienz und Recycling, sind von entscheidender Bedeutung, um die wachsende Nachfrage nach leistungsstarken, nachhaltigen Chips zu decken. Technologie hat die Kraft, Lösungen zur Reduzierung klimabezogener Auswirkungen der Datenverarbeitung in der gesamten Technologiebranche und der restlichen globalen Wirtschaft zu beschleunigen.

Automatisierung und Digitalisierung sind der Schlüssel, um die Herausforderungen, die sich der Industrie auf dem Weg zu einer Netto-Null-Treibhausgasemission stellen, zu meistern. Durch die gemeinsame Bündelung ihrer Stärken und ihres Know-hows sind Siemens und Intel in der Lage, den positiven Wandel voranzutreiben.

Diese Presseinformation ist verfügbar unter: <https://sie.ag/ZvtFV>

Ansprechpartner für Journalisten

Siemens AG

Simon Krause

Tel.: +49 173 403-9683; E-Mail: krause.simon@siemens.com

Jil Huber

Tel.: +49 162 347-4144; E-Mail: jil-patricia.huber@siemens.com

Intel Corporation

Kiana Cacchione

Tel.: +1.602.989.0640; E-Mail: kiana.cacchione@intel.com

Folgen Sie uns auf Social Media:

- Siemens auf X: www.twitter.com/siemens_press
- Intel auf X: <https://twitter.com/intelnews>
- Intel auf LinkedIn: <https://www.linkedin.com/company/intel-corporation/>

Die **Siemens AG** (Berlin und München) ist ein führendes Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung – das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welt befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen. Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers – einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet.

Im Geschäftsjahr 2023, das am 30. September 2023 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 77,8 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 8,5 Milliarden Euro. Zum 30.09.2023 beschäftigte das Unternehmen weltweit rund 320.000 Menschen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.

Intel Corporation

Intel (Nasdaq: INTC) ist ein Branchenführer, der weltverändernde Technologien entwickelt, die globalen Fortschritt ermöglichen und das Leben bereichern. Inspiriert vom Mooreschen Gesetz entwickeln und fertigen wir Halbleiter

ständig weiter, um die größten Herausforderungen unserer Kunden zu lösen. Durch die Einbettung von Intelligenz in die Cloud, das Netzwerk, den Edge und jede Art von Computergerät erschließen wir das Potenzial von Daten, um Unternehmen und Gesellschaft zum Besseren zu verändern. Um mehr über Innovationen von Intel zu erfahren, gehen Sie zu newsroom.intel.com und intel.com.

© Intel Corporation. Intel, das Intel Logo und andere Intel Marken sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften. Andere Namen und Warenzeichen können Eigentum anderer sein.